

三季度营收净利双提升，看好 AI 带来的业绩增量

核心观点

公司以微钻、铣刀及精密刀具为发展重心，辅以刷磨轮、设备、耗材、膜类产品。公司产品涵盖钻针、铣刀、磨刷、自动化设备等一系列生产 PCB 所需的耗材及设备。随着 PCB 行业需求逐渐回暖以及 AI 的深化应用，公司把握住行业结构性发展机会，持续推动 PCB 刀具产品的迭代升级，高端产品结构不断优化。公司 Q3 营收、利润同比均快速增长，看好公司业绩增长。

事件

公司发布 2024 年三季度报告，前三季度公司营收 11.29 亿元，同比增长 21.72%，实现归母净利润 1.72 亿元，同比增长 1.75%，基本每股收益 0.42 元，同比增长 2.44%。

简评

1、公司 Q3 营收、利润同比均稳定增长。

公司前三季度营收 11.29 亿元，同比增长 21.72%，实现归母净利润 1.72 亿元，同比增长 1.75%，基本每股收益 0.42 元，同比增长 2.44%，毛利率 35.85%。第三季度公司实现营收 4.16 亿元，同比增长 20.74%，实现归母净利润 8334.86 万元，同比增长 31.49%，基本每股收益 0.2 元，同比增长 33.33%，毛利率 37.17%，环比提升 1.74pct。

2、公司为 PCB 刀具龙头企业，产品涵盖一系列生产 PCB 所需的耗材及设备。

公司以微钻、铣刀及精密刀具为发展重心，辅以刷磨轮、设备、耗材、膜类产品。公司产品涵盖钻针、铣刀、磨刷、自动化设备等一系列生产 PCB 所需的耗材及设备，钻针产品直径规格覆盖 0.035mm 到 6.75mm，铣刀产品直径规格覆盖 0.35mm-3.175mm，产品型号齐全，尺寸覆盖范围广。同时，公司自研 CVD 涂层、PVD 硬质涂层及 Ta-C 润滑涂层等各类涂层技术，提升刀具的使用性能，形成差异化竞争优势。

鼎泰高科 (301377.SZ)

投资评级

买入

吕娟

lyujuan@csc.com.cn

021-68821610

SAC 编号:S1440519080001

SFC 编号:BOU764

于芳博

yufangbo@csc.com.cn

010-56135159

SAC 编号:S1440522030001

许光坦

xuguangtan@csc.com.cn

SAC 编号:S1440523060002

辛侠平

xinxiaping@csc.com.cn

010-56135158

SAC 编号:S1440524070006

发布日期：2024 年 10 月 28 日

当前股价：20.33 元

主要数据

股票价格绝对/相对市场表现 (%)

1 个月	3 个月	12 个月
33.84/13.16	14.21/2.79	8.43/-2.29
12 月最高/最低价 (元)		23.69/12.78
总股本 (万股)		41,000.00
流通 A 股 (万股)		7,102.40
总市值 (亿元)		83.35
流通市值 (亿元)		14.44
近 3 月日均成交量 (万)		314.72
主要股东		
广东太鼎控股有限公司		76.23%

根据 CPCA 2023 年 5 月 31 日公布的《第二十二届（2022）中国电子电路行业主要企业榜单》，公司在刀具类专用材料企业中排名第 1 位。根据 Prismark 研究报告，2023 年公司在全球 PCB 钻针销量市场占有率约为 26.5%，排名第 1 位。

公司与国内外众多知名 PCB 厂商建立了良好稳定的合作关系，并多次获得客户颁发的“金牌供应商”“优秀供应商”等奖项。公司主要客户包括健鼎科技、TTM 集团、深南电路、胜宏科技、崇达技术、景旺电子等国内外知名 PCB 生产厂商。其中，健鼎科技、深南电路、和景旺电子分别在 N.T.information 公布的世界 PCB 厂商排名中中位列第 7、9 和 15 名。

3、受益于 PCB 行业需求回暖以及 AI 应用，公司业绩持续增长。

随着 PCB 行业需求逐渐回暖以及 AI 的深化应用，公司把握住行业结构性发展机会，持续推动 PCB 刀具产品的迭代升级，高端产品结构不断优化。在 AI 领域，以 AI 服务器为例，相比传统服务器，AI 服务器主要新增了两种类型的 PCB：OAM 和 UBB。OAM 模组用以承载 GPU，UBB 则用来承载 OAM，让 GPU 之间互相连接发挥作用。英伟达推出新一代 GB200NVL72 机架式服务器，架构升级，superchip 的设计取代原 OAM、UBB 和 CPU 主板在各器件的互联互通功能，面积增大，对应 HDI 的需求量大幅提升；同时升级后的 superchip 板需要用到更高级别的 CCL 材料，对应处理刀具升级。

刀具产品方面，今年以来公司聚焦 AI、半导体等高端产品领域的微小钻研发，结合自研涂层的技术优势，不断优化产品结构，2024 年上半年，公司 0.2mm 及以下微钻销量占比约 18.49%，涂层钻针销量占比约 29.53%。

公司的泰国生产基地预计今年四季度实现规模量产，目前钻针规划的初期月产能 300-500 万支，后续将根据市场拓展进度逐步扩至月产能 1000 万支左右。铣刀月产能暂时规划为 50 万支，具体的扩建进度将根据海外客户的订单情况逐步调整。

4、盈利预测。

公司为 PCB 刀具类专用材料企业龙头，受益于 PCB 行业回暖以及 AI 高景气度，看好公司业绩增长，我们预计公司 24-26 年归母净利润分别为 2.8、4.1、4.9 亿元，对应当前市值 PE 为 30X、20X、17X，给予买入评级。

5、敏感性测试。

以上给的业绩指引为中性预期，若在营收增长率、毛利率、期间费用等方面进行正负 3% 的浮动，+3% 为乐观预期，-3% 为悲观预期。则乐观预期公司 24-26 年利润分别为 3.1、4.3、5.4 亿元，对应当前市值 PE 为 27X、20X、17X；悲观预期公司 24-26 年利润分别为 2.5、3.7、4.5 亿元，对应当前市值 PE 为 34X、23X、19X。

风险提示：随着行业的不断发展，市场竞争可能会日益激烈，鼎泰高科需要持续投入研发和市场推广，以维持其市场地位；随着技术的不断进步，鼎泰高科的产品可能面临技术过时或更新换代的风险，这可能导致其市场份额下降或产品竞争力减弱；鼎泰高科的产品，特别是 PCB 钻针等微型刀具，可能面临技术替代的风险。随着激光钻孔等新技术的发展，如果鼎泰高科无法持续保持技术创新能力，其产品的市场竞争力可能会受到影响；鼎泰高科的产品广泛应用于 PCB、数控精密机件等领域，如果下游市场需求发生变化，如需求减少或转向其他替代品，鼎泰高科的销售业绩可能会受到影响。

分析师介绍

吕娟

董事总经理，研委会副主任，上海区域总监，高端制造组组长，机械行业首席分析师。复旦大学经济学硕士，法国 EDHEC 商学院金融工程交换生，河海大学机械工程及自动化学士，2007.07-2016.12 曾就职于国泰君安证券研究所任机械首席分析师，2017.01-2019.07 曾就职于方正证券研究所任董事总经理、副所长、机械首席分析师。曾获新财富、金牛、IAMAC、水晶球、第一财经、WIND 最佳分析师第一名。2021 年新财富最佳分析师机械行业第二名。

于芳博

中信建投人工智能组首席分析师，北京大学空间物理学学士、硕士，2019 年 7 月加入中信建投，主要覆盖人工智能等方向，下游重点包括智能汽车、CPU/GPU/FPGA/ASIC、EDA 和工业软件等方向

许光坦

机械行业分析师。上海交通大学硕士，2021.4-2023.5 曾就职于东北证券研究所，2023 年 5 月加入中信建投证券，专注于机床、机器视觉、复合集流体、注塑机、包装机械等行业的研究。

辛侠平

中信建投证券人工智能行业分析师，中央财经大学硕士，曾从事通信行业研究工作，2022 年加入中信建投人工智能团队，重点覆盖人工智能、AI 芯片、智能驾驶等领域。

评级说明

投资评级标准		评级	说明
报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后 6 个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的 6 个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A 股市场以沪深 300 指数作为基准；新三板市场以三板成指为基准；香港市场以恒生指数作为基准；美国市场以标普 500 指数为基准。	股票评级	买入	相对涨幅 15% 以上
		增持	相对涨幅 5%—15%
		中性	相对涨幅-5%—5%之间
		减持	相对跌幅 5%—15%
		卖出	相对跌幅 15% 以上
	行业评级	强于大市	相对涨幅 10%以上
		中性	相对涨幅-10-10%之间
		弱于大市	相对跌幅 10%以上

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：（i）以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，结论不受任何第三方的授意或影响。（ii）本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构（以下合称“中信建投”）制作，由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格，本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

在遵守适用的法律法规情况下，本报告亦可能由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础，不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料，但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断，该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更，亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件，而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况，报告接收者应当独立评估本报告所含信息，基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策，中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保，亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内，中信建投可能持有并交易本报告中所提公司的股份或其他财产权益，也可能在过去 12 个月、目前或者将来为本报中所提公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点，分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系，分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可，任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容，亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有，违者必究。

中信建投证券研究发展部

北京
 朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼 18 层
 电话：（8610）56135088
 联系人：李祉瑶
 邮箱：lizhiyao@csc.com.cn

上海
 上海浦东新区浦东南路 528 号南塔 2103 室
 电话：（8621）6882-1600
 联系人：翁起帆
 邮箱：wengqifan@csc.com.cn

深圳
 福田区福中三路与鹏程一路交汇处广电金融中心 35 楼
 电话：（86755）8252-1369
 联系人：曹莹
 邮箱：caoying@csc.com.cn

中信建投（国际）

香港
 中环交易广场 2 期 18 楼
 电话：（852）3465-5600
 联系人：刘泓麟
 邮箱：charleneliu@csci.hk